



美格智能 SRM821 模组

5G NR M.2封装模组

美格智能5G模组SRM821是一款专为IoT/FWA等应用而设计的5G Sub-6GHz模组,该模组采用M.2封装,尺寸为30x52x2.3mm,采用了紫光展锐唐古拉V510国产芯片方案,可支持5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种网络架构,支持国内所有运营商频段需求,并向下兼容4G/3G网络,同时可扩展支持多组5G网络切片、空口精准授时、5G LAN等R16新技术,可为国内客户带来完美的5G体验。

SRM821模组采用M.2封装,符合行业M.2标准接口定义,标准尺寸,单面布局。支持USB3.0、PCIe2.0、GPIO等接口,内部集成eSIM,可适配多种类型操作系统(Android, Linux, Windows 7/8/10等),同时内置了丰富的网络协议。具有接口标准,底板设计简单,更易组装等优势,可广泛应用于FWA、工业互联网、电力、车联网、高清视频、远程医疗、智慧城市等垂直行业。

主要优势:

- 支持3GPP R15标准,支持SA&NSA,向下兼容4G/3G
- 单面布局,标准尺寸
- 国产芯片及射频方案,高性能和高性价比
- 采用4天线组合,天线数量更少
- 预留esim支持
- 支持USB3.0、PCIe2.0高速率接口
- 可扩展支持5G网络切片、空口精准授时、5G LAN等新技术



5G NR



SA&NSA



M.2封装



USB3.0



PCIe 2.0



MIMO



-40°C-85°C



VoNR/VoLTE

MeiG Smart

SRM821 模组

5G NR M.2封装模组

MEIG 美格

股票代码:002881

基本属性:

- 封装: M.2封装
- 尺寸: 30.0×52.0×2.3mm
- 重量: < 8g

模组速率:

- 5G NR Sub-6GHz:
 - MIMO 4*4, 256QAM
 - Downlink up to 2.0Gbps
 - Uplink up to 900Mbps
- LTE:
 - Downlink up to 400Mbps
 - Uplink up to 150Mbps
- DC-HSPA+:
 - Downlink up to 42.4Mbps
 - Uplink up to 5.76Mbps

驱动&工具:

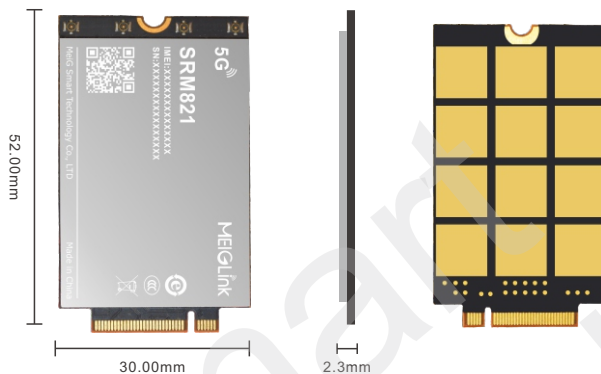
- 驱动: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Android
- 工具: 一键式升级工具, Gobinet拨号工具
- FOTA 升级

模组接口:

- 1xUSB 2.0/USB 3.0
- 1xPCIe Gen2.0
- 1xUART
- 2xSIM卡接口(1.8 / 3.0V)
- eSIM
- 天线接口: 主/分集/MIMO天线, 共4根
- Power On/Off, Reset
- GPIOs

认证信息:

- CCC*/SRRC*/CTA*



发射功率:

- Class 2 for N41/N78/N79
- Class 3 for LTE-FDD
- Class 3 for LTE-TDD

环境温度湿度特性:

- 常规工作温度: -30°C to -75°C
- 扩展工作温度: -40°C to -85°C
- 存储温度: -45°C to -90°C
- 湿度: 5%~95%

网络协议:

- RNDIS/NCM/ECM/IPv4/IPv6/TCP/UDP

SRM821系列频段信息:

5G NR NSA: N41/N78/N79
5G NR SA: N1/N28/N41/N78/N79
LTE-FDD: B1/B3/B5/B8
LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA: B1/B8

备注: * 研发中

